

2021年2月18日

各位

会社名 株式会社シキノハイテック
代表者名 代表取締役社長 浜田 満広
(コード番号: 6614 東証JASDAQ)
問合せ先 常務取締役管理本部長 広田 文男
(TEL 0765-22-3477)

2021年3月期の業績予想について

2021年3月期(2020年4月1日から2021年3月31日)における当社の業績予想は、次の通りであります。

【個別】

(単位: 百万円、%)

項目	決算期	2021年3月期 (予想)			2021年3月期 第3四半期累計期間 (実績)		2020年3月期 (実績)	
		対売上 高比率	対前期 増減率		対売上 高比率		対売上 高比率	
売上高		4,600	100.0	1.5	3,200	100.0	4,531	100.0
営業利益		204	4.4	▲13.2	94	3.0	235	5.2
経常利益		210	4.6	▲10.7	97	3.0	235	5.2
当期(四半期)純利益		134	2.9	17.6	62	2.0	113	2.5
1株当たり当期 (四半期)純利益		44円25銭			20円99銭		37円97銭	
1株当たり配当金		0円00銭			—		0円00銭	

- (注) 1. 当社は、連結財務諸表及び四半期連結財務諸表を作成しておりません。
2. 2020年11月11日付で、普通株式1株につき10株の株式分割を行っておりますが、上記では、2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期(四半期)純利益を算出しております。
3. 2020年3月期(実績)及び2021年3月期第3四半期累計期間(実績)の1株当たり当期(四半期)純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。
4. 2021年3月期(予想)の1株当たり当期純利益は、公募予定株式数(1,150,000株)を含めた予定期中平均発行済株式数により算出し、オーバーアロットメントによる売出しに関する第三者割当増資分(最大177,000株)を考慮しておりません。
5. 当社は定款において第2四半期末日および期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では期末日における配当予想額は未定であります。

ご注意: この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」(並びに訂正事項分)をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。また、本記者発表文に記載されている当社の計画、見積り、予測、予想その他の将来情報については、本記者発表の作成時点における当社の判断又は考えに過ぎず、実際の当社の経営成績、財政状態その他の結果は、経済状況の変化、市場環境の変化及び他社との競合、外国為替相場の変動等により、本記者発表文の内容又は本記者発表文から推測される内容と大きく異なることがあります。

【2021年3月期業績予想の前提条件】

1. 当社全体の見通し

当社は、1975年1月株式会社シキノとして設立し、半導体に関連する事業分野について設計・生産等の事業を主たる事業としております。経営理念である「我が社は、お客様の信頼を得る製品とサービスを創り出し、立ち止まらず、高いモラルを有し、発展し続ける企業を目指します。」の考えのもと、電子システム事業、マイクロエレクトロニクス事業、製品開発事業を展開しております。電子システム事業においては、計測関連製品では自動走行運転に関する装置の検査機器開発を行い、半導体検査装置関連製品は開発から製造までの一貫体制で対応しております。マイクロエレクトロニクス事業においては、LSI設計・開発及びIPコア(*1)（スマートフォン等）開発を行っており、製品開発事業においては、画像技術を活用した産業用組込カメラ（ATM、ドローン、ロボット等）カメラモジュールを組み合わせた画像処理（QRコード等）や画像センシングのカスタム開発等を行っております。

製造拠点である魚津工場では、電子機器製品や半導体検査装置、画像処理システム、カメラモジュール製品などを生産しており、魚津工場、大阪デザインセンター、東京デザインセンター、九州事業所及び福岡デザインセンターの各拠点では設計業務を行っております。また、半導体関連製品において、自社にて設計・製造及び販売の一貫体制を整えております。

(*1) 「LSI」とは、シリコンウェハ（半導体製品の製造に使用される導体と絶縁体の中間の性質を持つ物質）で形成される大規模集積回路を意味しております。「LSI」は、Large Scale Integrationの略称であり、「半導体」とも呼ばれています。

また「IPコア」とは、LSIを構成するための部分的な回路情報のうち、特に単一機能でまとめられた物を指します。「IPコア」は、Intellectual Property Coreの略称です。

わが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響により、引き続き厳しい状況にありますが、輸出や生産、個人消費などで持ち直しの動きもみられ、少しずつ回復へと向かって動き出してまいりました。しかしながらまだ終息時期の見通しは立っておらず、世界や日本の経済へのマイナス影響は長期化することが懸念されています。このような状況のもと、当社は主に自動車市場向け、産業用機器市場向け、スマートフォン市場向けに事業拡大を進めるとともに高度化する市場ニーズへの更なる迅速な対応を目指し、高付加価値新製品の開発・生産・販売体制の強化を積極的に推進するとともに、コスト削減にも取り組んでまいりました。

2021年3月期の業績予想につきましては、売上高4,600百万円（前期比1.5%増）、営業利益204百万円（前期比13.2%減）、経常利益210百万円（前期比10.7%減）、当期純利益134百万円（前期比17.6%増）を見込んでおります。

なお、新型コロナウイルスの感染の再拡大等や米中貿易摩擦の加速などにより、国民生活および経済環境への影響が生じた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

各セグメントの内容は以下の通りです。

(1) 電子システム事業

電子システム事業では、半導体製造工場で使用される検査関連機器及び装置を扱っております。半導体検査業務は顧客企業の製品に必要な工程であり、特に車載向けの顧客製品では、同工程は重要な検査工程です。当社は半導体検査工程のうち、主に車載用半導体部品に検査実施が要求されるバーンイン装置とバーンインボード(*2)及び周辺機器や治具の開発・製造を行っております。

また、半導体周辺機器開発により培われた技術で、産業顧客の製品生産工程における検査ボードや専

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。また、本記者発表文に記載されている当社の計画、見積り、予測、予想その他の将来情報については、本記者発表の作成時点における当社の判断又は考えに過ぎず、実際の当社の経営成績、財政状態その他の結果は、経済状況の変化、市場環境の変化及び他社との競争、外国為替相場の変動等により、本記者発表文の内容又は本記者発表文から推測される内容と大きく異なることがあります。

用計測器、更には各種電子機器の開発・設計・製造を行っております。

(*2) バーンインとは半導体の初期不良を除去する選別方法の1種で、半導体製品を通常の使用状態よりも高温環境下で動作させることで、通常の使用環境であれば2～3年以内で故障するおそれのある半導体を取り除くテスト工程（パッケージバーンインテスト）のことで、バーンイン装置は高温環境下をつくる試験装置、バーンインボードは半導体を動作させる周辺回路を持ち、バーンイン装置内で駆動するボードとなります。

(2) マイクロエレクトロニクス事業

マイクロエレクトロニクス事業では、半導体のLSI設計（アナログ・デジタル）及びIPコアの開発などを行っております。

LSI設計事業アナログ系(*3)では、回路設計、レイアウト設計、特性評価から、テスト部門との連携によるLSIテストプログラム作成までの一貫設計体制を構築しております。また、設計技術者の人材派遣を行っております。特に、高速I/F回路及び電源IC(*4)の設計技術で設計・評価技術を確立しております。また、LSI設計事業デジタル系(*3)では、画像処理及び高速I/F回路をメインに設計しております。開発したLSIの主な用途としましては、デジタル情報家電（携帯電話、DVD、デジタルカメラ、液晶テレビなど）及び車載機器関連（カーナビゲーションなど）となっております。

ASIC(*5)開発で培った画像処理技術をベースに、オリジナルIPコア(*6)の開発を行っており、豊富な実績を誇るIPコアのライセンスから周辺回路設計やカスタマイズまで対応可能であります。

(*3)アナログ系LSIとは、情報量が連続して変化する電圧、電流、周波数等のアナログ信号を処理する回路構成を持ったアナログ半導体のことで、デジタルLSIとは、アナログ値をデジタル値（2進数）に置き換えるデジタル信号を、計算式を演算する事で処理する回路を持ったデジタル半導体のことです。

(*4) 高速I/F回路とは、受信機・通信機において周波数変換された信号を高速処理する電子回路のことです。

(*5) ASICとは、ある特定の用途のために設計されたICのことで、注文に応じてゼロから設計するフルカスタムICと、あらかじめ特定の機能を持った回路ブロックを組み合わせた「半完成品」をもとに、配線を変えることで要求に合わせるセミカスタムICの2種類があります。

(*6) IPコアとは、LSIを構成するための部分的な回路情報のうち、特に単一機能でまとめられた物を指します。Intellectual Property Coreの略称です。

(3) 製品開発事業

画像技術を活用した産業用組込カメラ、画像処理カメラの開発・製造及びシステムの開発を行っております。複雑な画像処理をカメラ単体で実現可能としており、画像検査や計測、各種認識処理等、様々な用途に幅広く活用できます。専用クリーンルームを完備した国内自社工場での一貫生産による、高信頼性と中長期にわたる安定供給を実現しています。

システム開発事業は、主に画像処理システムを開発しております。カメラを中心としたソフト開発を行っており、組み込みカメラシステム分野での技術力が強みとなっております。

2. 業績予想の前提条件

(1) 売上高

(電子システム事業)

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。また、本記者発表文に記載されている当社の計画、見積り、予測、予想その他の将来情報については、本記者発表の作成時点における当社の判断又は考えに過ぎず、実際の当社の経営成績、財政状態その他の結果は、経済状況の変化、市場環境の変化及び他社との競合、外国為替相場の変動等により、本記者発表文の内容又は本記者発表文から推測される内容と大きく異なることがあります。

電子システム事業の第3四半期累計期間における売上高は、1,155百万円となりました。コロナウイルスの感染拡大による半導体顧客の需要停滞による設備導入抑制が影響し、バーンイン装置、車載用バーンインボード他、半導体信頼性商材の受注が、前年同時期比26.3%減となりました。一方、受託開発案件につきましては前年同時期比34.0%増と、順調に推移しました。このような情勢のなか、半導体顧客においてニーズが高まる装置レンタル、保守・メンテナンスにおいて、検査用部品を導入して点検の効率改善化や、協力企業との連携強化等による販売力強化にも取り組みました。

2021年3月期売上高の予想は、半導体商材につきましては引き続き厳しい状況が続きますが、産業用途向け受託案件の受注が好調であることから、1,744百万円（前期比1.8%減）を予定しております。予想数値の算出にあたっては、既存顧客からの継続案件と、顧客および商材別にヒアリングを実施した際の情報を基に、過年度の実績や需要周期、それぞれの確度も勘案し集計しております。

(マイクロエレクトロニクス事業)

マイクロエレクトロニクス事業の第3四半期累計期間における売上高は、1,321百万円となりました。アナログLSI開発関連の既存顧客からの受注が堅調に推移し、車載関連やデジタルLSI開発関連においては売上が減少したものの、得意技術である高速IF&センサー、画像分野の受注が、前年同時期比20.8%増となるなど、堅調に推移いたしました。また、IP販売関連においてJPEG-IPライセンス収入がデジタル製品市場の低迷により低調に推移（前年同時期比10.7%減）致しましたが、スマートフォン向けに安定した量の販売を継続しております。

2021年3月期売上高の予想は、米国の半導体輸出規制の影響によって、一部顧客における半導体開発の動きが鈍化することを見込み、1,779百万円（前期比3.5%減）を予定しております。予想数値の算出にあたっては、既存顧客からの継続案件、顧客からのヒアリング、フォーキャスト情報、新規顧客となり得る取引先の先行情報を基に、それぞれの確度も勘案し集計しております。

(製品開発事業)

製品開発事業の第3四半期累計期間における売上高は、722百万円となりました。カメラ機能を利用した社会インフラである、端末機器、交通、金銭機器や、情報入出力機器市場を中心に既存取引先強化、取引先商社との連携強化、サンプル販売の強化、産業用・医療分野における組込カメラの積極的な営業活動により、売上高は前年同時期比12.2%増となるなど好調に推移しました。また、カメラを利用した新しい市場ニーズに対応するための研究開発投資を引き続き行っております。

2021年3月期売上高の予想は、大口顧客の受注もあり1,076百万円（前期比18.0%増）を予定しております。予想数値の算出にあたっては、受注が相当程度確定している案件に顧客の生産計画・引合情報を加味した上で、確度も勘案し集計しております。

(2) 売上原価、売上総利益

(電子システム事業)

売上原価は主に労務費と資材費・外注費から構成されております。労務費については、既存の原価社員の人件費をベースに、支給見込みの賞与額及び人員計画における採用人数と退職人数を考慮して策定しております。資材費、外注費については、売上高の予想を基に、個別に見積を行い算出しております。第3四半期累計期間における売上原価は977百万円、売上総利益が178百万円となりました。

2021年3月期の売上原価は、売上高の減少に伴い1,420百万円（前期比0.5%減）、売上総利益は323百万円（前期比7.3%減）を見込んでおります。

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。また、本記者発表文に記載されている当社の計画、見積り、予測、予想その他の将来情報については、本記者発表の作成時点における当社の判断又は考えに過ぎず、実際の当社の経営成績、財政状態その他の結果は、経済状況の変化、市場環境の変化及び他社との競合、外国為替相場の変動等により、本記者発表文の内容又は本記者発表文から推測される内容と大きく異なることがあります。

(マイクロエレクトロニクス事業)

売上原価は主に労務費から構成されております。労務費については、既存の原価社員の人件費をベースに、支給見込みの賞与額及び人員計画における採用人数と退職人数、および人的リソースを考慮した派遣社員費用を見積もり策定しております。第3四半期累計期間における売上原価は959百万円、売上総利益が361百万円となりました。

2021年3月期の売上原価は、テレワークによる旅費交通費の減少などの影響により、1,279百万円(前期比5.0%減)、売上総利益は499百万円(前期比0.7%増)を見込んでおります。

(製品開発事業)

売上原価は主に労務費と資材費・外注費から構成されております。労務費については、既存の原価社員の人件費をベースに、支給見込みの賞与額及び人員計画における採用人数と退職人数を考慮して策定しております。資材費、外注費については、売上高の予想を基に、個別に見積りを行い算出しております。第3四半期累計期間における売上原価は590百万円、売上総利益が131百万円となりました。

2021年3月期の売上原価は、売上高の伸長に伴い862百万円(前期比14.8%増)、売上総利益は213百万円(前期比32.7%増)を見込んでおります。

(3) 販売費および一般管理費、営業利益

販売費および一般管理費については、営業・本社部門等の人件費や主に業務委託費および研究開発費等から構成されております。人件費は既存社員の人件費をベースに、支給見込みの賞与額及び人員計画における採用人数と退職人数を考慮して策定しております。業務委託費や研究開発費等は、個別的に発生する費用の増加要因を勘定科目ごとに集計し算出しております。第3四半期累計期間における販売費および一般管理費は577百万円、営業利益は94百万円となりました。

2021年3月期の予想につきましては、上場関連費用を見込んでおり、832百万円(前期比8.0%増)を予定しており、営業利益は204百万円(前期比13.2%減)を見込んでおります。

(4) 営業外収益・費用、経常利益

営業外収益については、主に研究開発の助成金や各種補助金で9百万円、営業外費用については、主に支払利息として6百万円を見込んでおります。第3四半期累計における経常利益は97百万円となりました。

2021年3月期の経常利益予想につきましては、210百万円(前期比10.7%減)を見込んでおります。

(5) 特別利益・損失、当期純利益

第3四半期累計期間における当期純利益は62百万円となりました。また、2021年3月期の予想につきましては、134百万円(前期比17.6%増)を見込んでおります。

特別損益は見込んでおらず、法人税等については、法人税、住民税及び事業税に税効果会計による法人税等調整額を加味して算出しております。

【業績予想に関するご留意事項】

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要因によって異なる場合がございます。

以上

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」(並びに訂正事項分)をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。また、本記者発表文に記載されている当社の計画、見積り、予測、予想その他の将来情報については、本記者発表の作成時点における当社の判断又は考えに過ぎず、実際の当社の経営成績、財政状態その他の結果は、経済状況の変化、市場環境の変化及び他社との競争、外国為替相場の変動等により、本記者発表文の内容又は本記者発表文から推測される内容と大きく異なることがあります。